



**16V, 15A, 3mΩ** R<sub>DS\_ON</sub>, 带电流监控功能的 热插拔保护器件

## The Future of Analog IC Technology

## 描述

MP5022C 是一款热插拔保护器件,用于保护输出端电路不受输入端瞬态的影响。MP5022C 也可以保护输入不受输出短路和瞬态影响。

启动期间,通过设置输出电压上升斜率来限制浪涌电流。输出电压上升斜率由 SS 引脚外接电容控制。

通过采样 FET 拓扑结构来限制最大的输出负载电流。限流值大小由 ISET 与地之间的低功率电阻设置。

由内部充电泵驱动功率器件的栅极来控制具有极低导通电阻(3mΩ)的功率 FET 导通。

MP5022C 还包含 IMON 功能,可通过设置 IMON 与地之间的电阻值,生成与器件电流成正比的电压。

同时具有全方位的保护特性,包括限流保护、过温保护、受损 MOSFET 检测、过压保护(OVP)和欠压保护(UVP)。

MP5022C 采用 QFN-22 (3mmx5mm) 封装。

## 特性

- 输入电压范围: 4.5V 至 16V
- 集成 3mΩ 功率 MOSFET
- 可调限流功能
- 输出电流测量
- ±3%电流监控精度 (6A < lo < 15A)</li>
- 短路保护快速响应(<200ns)</li>
- PG 检测和 FLTB 指示
- VIN = 0 时, PG 置低
- 输入-输出短路检测
- 外部软启动功能
- 可编程的 LOADEN 消隐时间
- 带迟滞的可配置过压锁定
- 欠压锁定(UVLO)
- 过温保护
- 采用小尺寸 QFN-22 (3mmx5mm) 封装

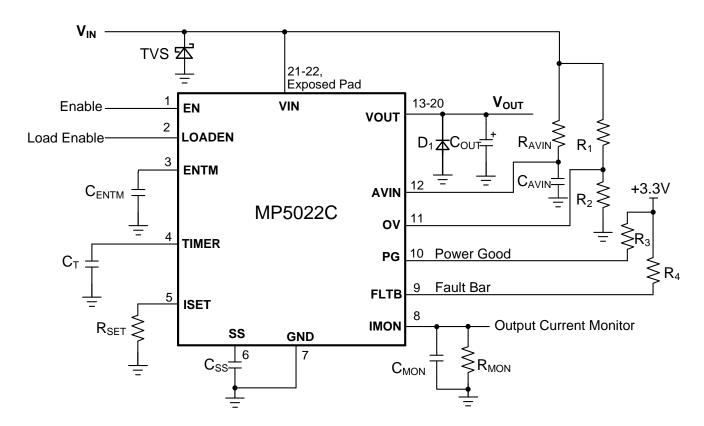
### 应用

- 热插拔
- PC卡
- 硬盘驱动
- 服务器
- 网络应用
- 笔记本电脑

所有 MPS 产品都保证无铅,无卤素,并且遵守 RoHS 规范。如需查询具体芯片环保等级,请访问 MPS 官网之质量保证。"MPS"和"The Future of Analog IC Technology"均为 MPS 注册商标。



# 典型应用





# 订购信息

产品型号*	封装	顶标
MP5022CGQV	QFN-22 (3mmx5mm)	见下文

<sup>\*</sup>对于编带和卷盘包装,请添加后缀-Z(例如 MP5022CGQV-Z)

### 顶标

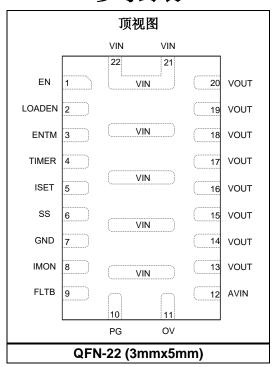
<u>MPYW</u> <u>5</u>022 CLLL

MP: MPS 前缀 Y: 年份代码 W: 周代码

5022C: 产品型号前5位

LLL: 批次号

# 参考封装





## 

<i>热阻</i> <sup>(4)</sup>	$oldsymbol{ heta}_{JA}$	$\boldsymbol{\theta}_{JC}$	
QFN-22 (3mmx5mm)	46	10°C/V	٧

#### 注:

- 1) 超过这些限定值可能会损坏芯片。
- 2) 最大可允许耗散功率是最大结温 T<sub>J</sub>(MAX)、结温-环境热阻 θ<sub>JA</sub>和环境温度 T<sub>A</sub>的函数。任何环境温度下允许的最大连续耗散功率由 P<sub>D</sub>(MAX) = (T<sub>J</sub>(MAX)-T<sub>A</sub>)/θ<sub>JA</sub> 计算得出。超过最大允许耗散功率会使芯片温度过高,导致稳压器进入热保护状态。内部热保护电路保护芯片免受永久性损坏。
- 3) 设备不能保证在其工作条件之外运行。
- 4) 上述数据是在 JESD51-7(4 层板)上测量所得。



## 电气特性

测试条件为  $V_{IN}$  = 12V,  $R_{SET}$  = 10.2k,  $C_{OUT}$  = 470 $\mu$ F,  $T_J$  = 25°C, 除非另有注明。

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电流	•		'			•
		EN = 高电平,空载		1.3	2.0	mA
静态电流	lα	故障锁定		1.3		mA
		$EN = 0$ , $V_{IN} = 16V$			700	μA
功率 FET		T	T	1	1	1
通态电阻	R <sub>DS(ON)</sub>	$T_J = 25^{\circ}C$		3	4	mΩ
	, ,	$T_J = 85^{\circ}C^{(5)}$		3.8	4.8	
关断漏电流	loff	$V_{IN} = 24V, EN = 0V$			1	μA
最大连续电流(5)	I <sub>OUT_MAX</sub>		15			Α
过温关断保护	1		u.	•		
关断温度 <sup>(5)</sup>	tsтD			145		°C
欠压保护(UVLO)						
输入欠压保护阈值	V <sub>IN UVLO</sub>	输入电压 上升阈值		4.15V	4.4	V
输入欠压保护阈值迟滞	V <sub>IN</sub> uvlohys			0.25		V
LOADEN						
低电平输入电压	V <sub>L</sub>				0.9	V
高电平输入电压	V <sub>H</sub>		2.3			V
软启动(SS)						
SS上拉电流	Iss	Vss = 0V	10	12.5	15	μΑ
限流	·					
正常工作下的限流值	I <sub>Limit_NO</sub>	R <sub>SET</sub> = 10.2k	11.34	12.6	13.86	Α
过流响应时间(5)	t <sub>CL</sub>			20		μs
二次限流值	I <sub>LimitH</sub>	任意 R <sub>SET</sub>		36		Α
短路保护响应时间(5)	t <sub>SC</sub>			200		ns
输出电流监控	1		U.	•		
中沙立林區大		6A < I <sub>OUT</sub> < 15A	9.7	10	10.3	μA/A
电流采样增益	Aimon	3A < Iоит < 6A	9.5	10	10.5	μΑ/A
最大 IMON 电压	VIMON				3	V
计时器	<u>.</u>		•			
上升电压阈值	V <sub>TMR</sub> H		1.2	1.24	1.28	V
插入延时充电电流	Insert		34.5	43	51.5	μA
故障检测充电电流	I <sub>FLTD</sub>		175	215	255	μA
放电 R <sub>DS(ON)</sub>	R <sub>FLTE</sub>	I <sub>OUT</sub> < I <sub>Limit</sub>		35	70	Ω
LOADEN 消隐时间 (ENTM)		l .	I	1	ı	I .
上升电压阈值	Ventmrh		1.2	1.24	1.28	V
充电电流	lentmcc		0.8	1.1	1.4	μA
,		I	0.0			·



## 电气特性 (续表)

测试条件为  $V_{IN}$  = 12V,  $R_{SET}$  = 10.2k,  $C_{OUT}$  = 470 $\mu$ F,  $T_{J}$  = 25°C,除非另有注明。

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
使能						
上升阈值	VENRS		1.258	1.325	1.391	V
迟滞	VENHYS			170		mV
过压(OV)						
OV 阈值	$V_{\text{OV\_TH}}$	Vov上升	1.2	1.24	1.28	V
OV 阈值迟滞	V <sub>OV_HYS</sub>	Vov下降		90		mV
故障汇总(FLTB)/电源正常(PG)						
低电平输出电压	$V_{OL}$	灌电流 1mA			0.2	V
故障汇总关断漏电流	I <sub>FLT_LKG</sub>	V <sub>FLTB</sub> = 3.3V			1	μA
故障传输延迟	<b>t</b> PDE	ISET 降至 1V 直至 FLTB 下拉		8	16	μs
PG 上升阈值 <sup>(5)</sup>	PG∨th_Hi			90%		Vin
PG 下降阈值	PG <sub>Vth_Lo</sub>			75%	80%	V <sub>IN</sub>
PG 关断漏电流	I <sub>PG_LKG</sub>	$V_{PG} = 3.3V$			2.5	μA
PG 低电平输出电压	V <sub>OL_100</sub>	V <sub>IN</sub> = 0V, 通过 100kΩ 电阻 上拉至 3.3V		600	720	mV
	V <sub>OL_10</sub>	V <sub>IN</sub> = 0V, 通过 10kΩ 电阻 上拉至 3.3V		720	870	mV

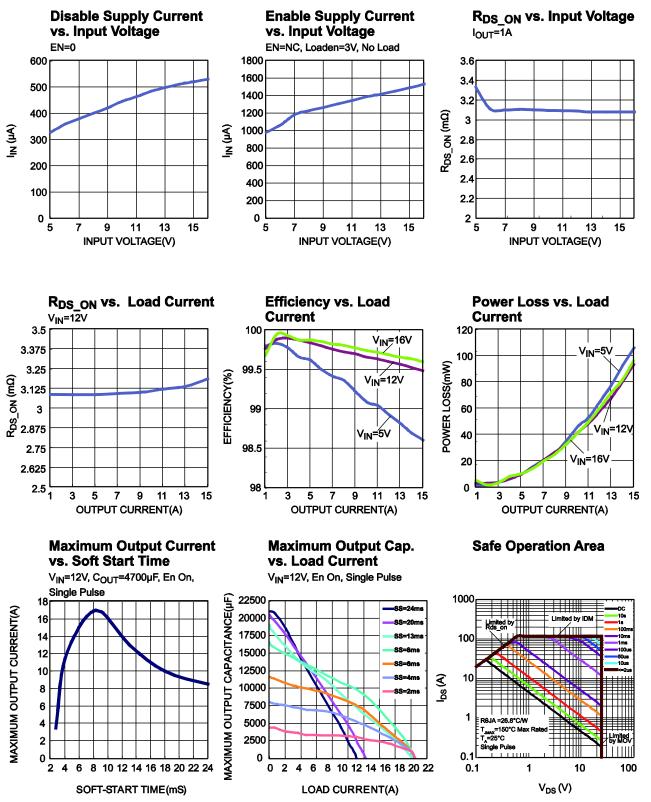
#### NOTE:注:

5) 由设计保证。



## 典型性能特性

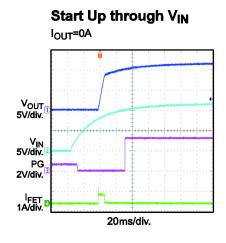
测试条件为  $V_{IN}$  = 12V,  $C_{OUT}$  = 470μF,  $C_{ENTM}$  = 1μF,  $C_T$  = 220nF,  $C_{SS}$  = 47nF,  $R_{SET}$  = 6.8k $\Omega$ ,  $T_A$  = +25°C , 除非另有注明。

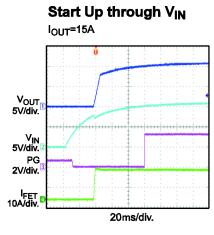


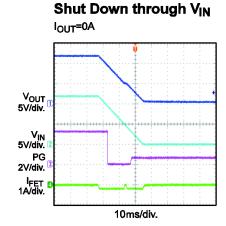


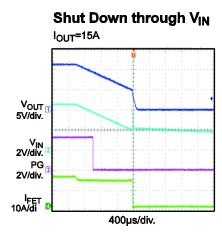
## 典型性能特性 (续表)

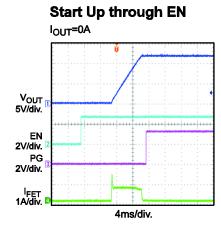
测试条件为  $V_{IN}=12V$ ,  $C_{OUT}=470\mu F$ ,  $C_{ENTM}=1\mu F$ ,  $C_{T}=220nF$ ,  $C_{SS}=47nF$ ,  $R_{SET}=6.8k\Omega$ ,  $T_{A}=+25^{\circ}C$ ,除非另有注明。

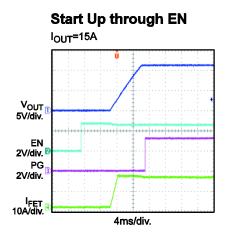




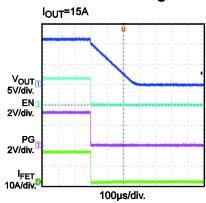








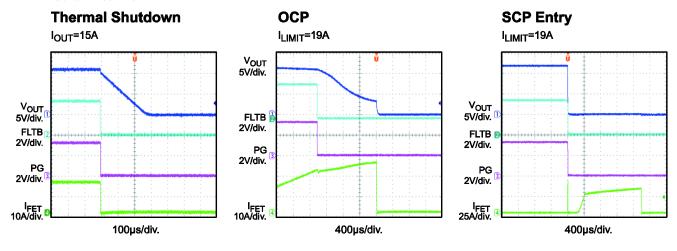
### **Shut Down through EN**

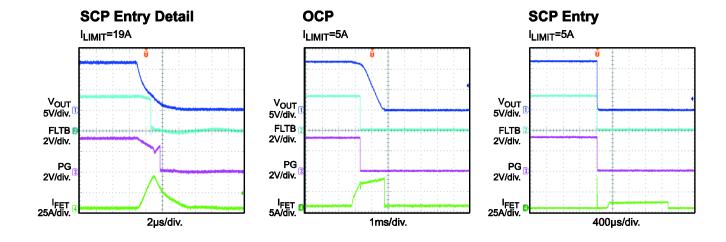


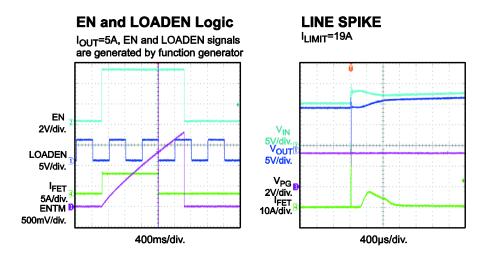


## 典型性能特性 (续表)

测试条件为  $V_{IN}$  = 12V,  $C_{OUT}$  = 470 $\mu$ F,  $C_{ENTM}$  = 1 $\mu$ F ,  $C_T$  = 220nF,  $C_{SS}$  = 47nF,  $R_{SET}$  = 6.8k $\Omega$ ,  $T_A$  = +25°C ,除非另有注明。









# 引脚功能

引脚#	名称	描述
1	EN	使能输入。EN 与 LOADEN 共同作用于主功率管的开通和关断。EN 内部上拉至高电平。
2	LOADEN	负载使能输入。与 EN 共同作用于主功率管的开通和关断(见表 1)。在 LOADEN 消隐时间过后,LOADEN 也可以用于关断功率开关,但不能再次开启。
3	ENTM	LOADEN 消隐时间设置。连接一个外部电容来设置 LOADEN 消隐时间。一旦 EN 置高,计时器便开始计时,LOADEN 被消隐。在故障/EN 低电平时,开关会关断,但在消隐时间内 LOADEN 低电平则不起作用。
4	计时器	<b>计时器设置。</b> 由外部电容设置热插拔插入时间延迟和故障暂停时间。
5	ISET	限流设置。在 ISET 和接地之间接一个电阻,用来设置过流限值。
6	SS	<b>软启动。</b> 由连接到 SS 引脚处的外部电容来设置输出电压的软启动时间。由内部电路控制启动时的输出电压转换速率。SS 浮空软启动时间将设置到最小值(1ms)。
7	GND	地。
8	IMON	输出电流监控。IMON 提供了一个与流经功率设备电流成正比的电压值。当电路处于 0A 至 15A 之间时,在接地处放置一个 10kΩ 的电阻(R <sub>MON</sub> ) 来生成 0V 至 1.5V 的电压。在应用电路中,需在 R <sub>MON</sub> 处并联一个 10nF 以上的电容。
9	FLTB	故障汇总。在过流或过温关断时,FLTB 为开漏输出,输出将被拉至地。可通过一个 10-100kΩ 的电阻将 FLTB 上拉至外部电源。
10	PG	电源正常指示。PG 为一个开漏输出。可通过一个 10-100k $\Omega$ 的电阻将 PG 上拉至外部电源。PG 高电平表示电源正常。
11	OV	过压使能输入。上拉 OV 至高电平,关断内部 MOSFET。连接 OV 至外部电阻分压器来设置过压阈值。
12	AVIN	用于 VCC 子调节器的内部电源。在 VIN 与 AVIN 之间连接一个 49.9Ω, 0603 封装的电阻,并在 GND 处连接一个 2.2μF 的旁路电容,以确保当 VOUT 至 GND 之间发生短路导致 VIN下降时,仍能正常工作。
13-20	VOUT	输出。VOUT 是指由 IC 控制的电压。必须在 VOUT 与 GND 之间接一个肖特基二极管,用来吸收负电压尖峰。
21, 22, 散 热焊盘	VIN	输入电源。



# 功能框图

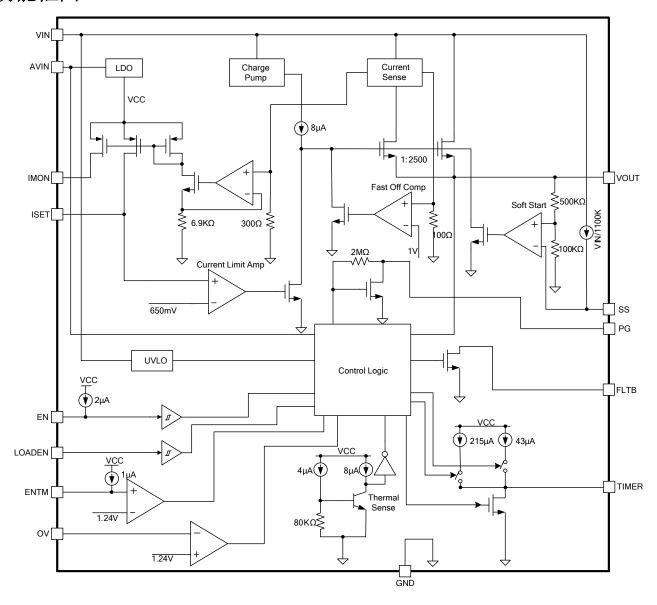


图 1: 功能框图



### 工作原理

MP5022C 用于限制将电路板插入带电背板电源时产生的负载的浪涌电流,从而限制背板的电压降和负载电压的 dV / dt。MP5022C 集成了输入电压、输出电压、输出电流以及芯片温度的监控功能,无需外接采样功率电阻、功率 MOSFET 和温度采样器件等。

#### 限流

MP5022C 提供了稳定的限流值,限流值大小可通过外部电阻进行编程。一旦器件电流达到限流阈值,内部电路就会通过调节栅极电压将功率 FET 电流保持在恒定值。为了限制电流,栅极-源极的电压必须保持在 4V 至 1V 左右。典型响应时间大约为 20µs。在响应时间内,输出电流可能存在一个很小的过冲。

当达到电流限后,故障计时器便开始计时。如果在故障暂停时间结束之前,输出电流降至电流限流阈值以下,则 MP5022C 恢复至正常工作。否则,如果限流时间超过故障暂停时间,则功率 FET 被锁定。

当芯片达到过流或过温阈值,FLTB 将被拉低,此时有大约 8µs 的延迟才能指示故障。正常工作时的限流值是外部限流电阻的函数。

#### 短路保护(SCP)

如果负载电流由于发生短路而迅速增加,其电流值可能在控制环路能够响应之前就会超过限流阈值。如果电流达到 36A 的二次限流值,内部快速关断电路动作,通过一个 100mA 下拉栅极放电电流来关断功率 MOSFET (见图 2)。通过限制流过器件的峰值电流来限制输入电压跌落。短路总响应时间大约为 200ns.。

当触发短路保护时,芯片重启来确定过载情况是否存在。如果是由输入线路瞬态导致的短路,则芯片可以正常工作。如果发生了真实的短路,则芯片完全锁定(见图2和图3)。

一旦达到 36A 的限流值,则 FLTB 置低,并保持低电平直至短路消除。

#### 故障计时器和重启

当电流达到限流阈值,内部 215μA 的故障计时器电流源对 TIMER 的外部电容(C)进行充电。在 TIMER 达到 1.24V 之前,如果过流保护状态消失,则 MP5022C 恢复至正常工作模式并且在过流保护消除后立即释放 TIMER。如果在 TIMER 达到 1.24V 之后,仍显示为过流保护状态,则关断功率 FET。可通过公式(1)确定 C<sub>T</sub> 的电容值:

$$C_{T} = \frac{215 \cdot t_{fault}}{1.24} \tag{1}$$

其中  $C_T$  为故障计时器电容(nF),  $t_{fault}$  为故障计时 (ms)。比如,100nF 电容会产出 0.58ms 的故障计时。

此外,这个故障计时电容也决定了启动时的插入延迟计时。



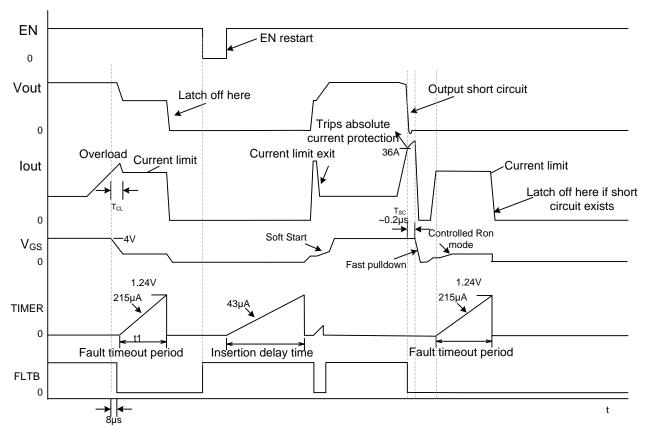


图 2: 过流保护

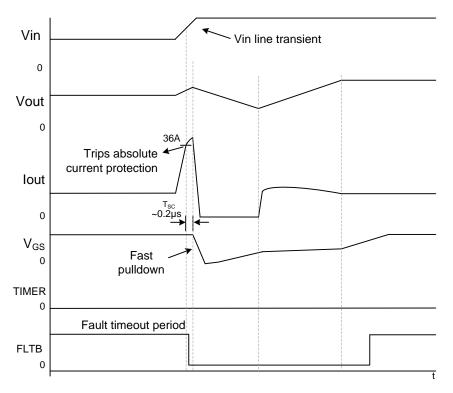


图 3: V<sub>IN</sub>线路瞬态响应



#### 电源正常 (PG)

电源正常(PG)用来指示输出电压是否处于输入电压对应的正常范围内。PG 也是开漏 FET 结构。通过一个 10-100kΩ 的电阻将 PG 上拉至外部电源。启动时,PG 置低,显示系统处于关闭状态,这能最大限度地减少 VOUT 上的负载,以降低浪涌电流和启动时的功耗。

当芯片符合以下条件时,PG信号上拉至高电平:

- $V_{OUT} > 90\% * V_{IN}$
- V<sub>GS</sub> > 3V
- $V_{OUT} > V_{IN} 0.8V$

一旦满足这些条件,系统可以全功率运行。

当  $V_{OUT}$  < 75% \*  $V_{IN}$ , PG 拉低。当 EN 低于其阈值时,PG 输出下拉至低电平。在没有输入的情况下,PG 在上拉电源存在的情况下,保持在低电平。

#### 故障汇总(FLTB)

故障汇总(FLTB)是一个开漏输出,用于显示是 否发生故障。通过一个 10-100kΩ 的电阻将 FLTB 上拉至外部电源。

当芯片过流、过温,或者 MOSFET 上电前短路,故障输出在大约 8µs 延迟后拉低。如果芯片发生短路并达到 36A 的二次限流值,则 FLTB 立即拉低。

当 MP5022C 恢复正常工作后,FLTB 恢复高电平。这意味着输出电压高于 PG 上升阈值设置的电压,且功率 FET 完全开通 (V<sub>GS</sub> > 3V)。

#### PG 和 FLTB 外部上拉电压

PG 和 FLTB 引脚需要一个外部电源。即使  $V_{IN}=0$  且 EN 禁用时,PG 的开漏输出也可以通过外部上拉电压工作。PG 和 FLTB 分别通过 10-100kΩ 的上拉电阻接至外部电源。

#### 上电时序

对于热插拔应用来说,MP5022C 的输入会在热插拔时承受电压尖峰/瞬态。这是由输入电路中的寄生电感和输入电容引起的。为了稳定输入电压,需要在主功率 FET 开启之前采用一个插入延迟。当输入电压达到 UVLO 阈值时,TIMER 会通过一个  $43\mu$ A 恒流源向外部电容( $C_T$ )充电。当 TIMER 电压达到 1.24V 时,插入延迟结束。可通过公式 (2)确定  $C_T$  的电容值:

$$C_{T} = \frac{43 \cdot t_{\text{delay}}}{1.24} \tag{2}$$

其中  $C_T$  为插入延迟计时器电容(nF),  $t_{fault}$  为插入延迟时间 (ms)。比如,100nF 的电容会产出 2.9ms 的插入延迟。

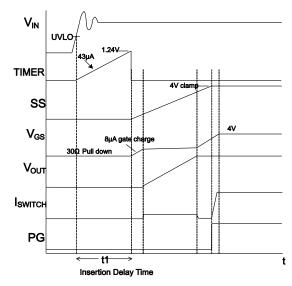


图 4: 启动时序

此外, TIMER 外接电容还将决定故障计时的时间, 详细内容请见第 12 页上的故障计时器和重启章节。

TIMER 达到 1.24V 之后,8µA 电流源开始给功率 FET 栅极充电,栅极电压上升。同时,TIMER 电压放电直至为零。一旦栅极电压达到其阈值 (Vesth),输出电压开始上升。上升时间由软启动电容决定。



#### 软启动(SS)

软启动时间由连接至 SS 引脚的电容决定。当插入 延迟时间结束后, SS 引脚内部与输入电压成正比 的恒流源给外接电容充电, 使其电压以相应的斜 率升高,输出电压将以相同的斜率上升。

SS 电容值可以根据以下公式(3)计算得出:

$$C_{SS} = \frac{6 \cdot t_{SS}}{R_{SS}} \tag{3}$$

其中, $t_{SS}$  为软启动时间, $R_{SS}$  为  $1.1M\Omega$ 。例如,47nF 的电容软启动时间为 8.6ms。

如果负载电容非常大,那么用于维持预设软启动时间的电流将会超过限流值。这种情况下,上升时间由负载电容和限流值控制。

SS 浮空,输出电压将快速上升。通过一个 8μA 的电流源升高 FET 的栅极电压。栅极充电电流控制输出电压的上升时间,最小的软启动时间近似为 1ms。

#### EN 和 LOADEN

EN 和 LOADEN 用于控制 MP5022C 的开启/关断 (见表 1)。

在 LOADEN 消隐期间,EN = 1 就可以开通芯片。在 LOADEN 消隐时间过后,必须 EN = 1 和 LOADEN = 1 才能开通器件。在任何时候,EN = 0 均可用于关闭芯片。一旦芯片被锁定,需重启 EN 或 VIN 才能使芯片重启。

表 1: EN/LOADEN 消隐时间

LOADEN 消隐时间超时?	EN	LOADEN	状态
N	0	0	Off
N	0	1	Off
N	1	0	On
N	1	1	On
Y	0	0	Off
Υ	0	1	Off
Y	1	0	Off
Y	1	1	On

注:在 LOADEN 消隐时间过后,LOADEN 也可以用于关断功率开关,但不能再次开启(见图 5)。

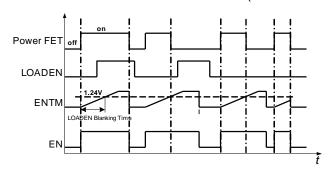


图 5: EN/LOADEN 时序图

EN由一个2µA的内部上拉电源拉高至高电平。

一旦芯片启动,插入延迟计时器会开启。当插入延迟时间结束,内部 8µA 的电流源对功率 FET 栅极充电。充电大约 1ms 后 V<sub>GS</sub> 达到阈值,然后输出电压以 SS 斜率上升。

#### LOADEN 消隐时间

假设 EN 为高电平,消隐时间内的 LOADEN 无效,该消隐时间可以进行设置 (见图 6)。在启动过程中,所有的故障功能都是有效的,所以如果检测到故障,电源开关就会关闭。然而,如果消隐期间 LOADEN 为低电平,则无法关闭开关。消隐时间结束后 LOADEN 恢复正常。

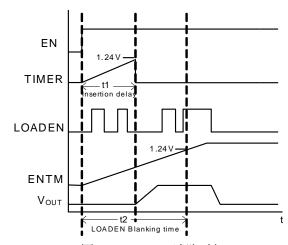


图 6: LOADEN 消隐时间



消隐时间可以通过接在 ENTM 处的电容进行设置。外接电容可以根据以下公式(4)计算得出:

$$C_{ENTM} = \frac{t_{LDNB} \cdot 10^{-6}}{1.24}$$
 (4)

其中 t<sub>LDNB</sub>为 LOADEN 消隐时间,C<sub>ENTM</sub>为 ENTM 外接电容。例如,1μF 的电容软启动时间为1.24s。

如果不使用 LOADEN,则需将 ENTM 连接至 GND。

#### 输入-输出短路检测

在启动期间,MP5022C 将输出电压超过  $V_{IN}$  - 0.8V 视为 MOSFET 短路。FLTB 拉低来显示处于故障状态,同时开关器件保持关闭状态。一旦  $V_{OUT} \le V_{IN}$  - 0.8,芯片则会正常启动。

#### 内部 VCC 稳压源

MP5022C 含有一个内部 4V 线性稳压源,通过输入降压电路,产生 4V 偏置电源,为低压电路供电。当  $V_{IN}$ 超过其 UVLO 阈值且 EN 为高电平时,稳压器使能。

#### **AVIN**

AVIN 为内部 VCC 稳压源的供电输入。在 VIN 与 AVIN 之间连接一个 49.9Ω 大小的电阻,并在 GND 处连接一个 2.2 μF 的旁路电容,以确保当 VOUT 至 GND 之间短路导致 VIN 下降时仍能正常工作。VIN 具有 UVLO 保护,但 AVIN 没有 UVLO 保护功能。不得单独使用 AVIN 关断 MP5022C。AVIN 供电电流典型值为 500μA。

#### 过压锁定保护(OVLO)

MP5022C 通过 OV 引脚监控电源电压,以确定是 否过压。从 VIN 到 OV 的外部电阻分压器可灵活 设置过压锁定阈值。

当 OV 引脚上的电压超过 1.24V 时,内部 MOSFET 截止,输出关闭。当 OV 引脚上的电压降至 1.24V-Vov\_HYS 以下时,内部 MOSFET 再次导通,输出通过软启动斜率上升。

#### 欠压锁定(UVLO)

如果电源(输入)低于欠压锁定(UVLO)阈值,则禁用输出,且 PG 变为低电平。

当电源超过 UVLO 阈值但未超过 OV 阈值时,则正常输出。

#### 输出电流监控

IMON 提供了一个与输出电流(也即流经功率器件的电流)成正比的电流值。电流检测放大器的增益为  $10\mu A/A$ ,这意味着 IMON 为每个主 FET 导通的放大器提供  $10\mu A$  的电流。 当 MOSFET 电流范围为 0A 至 20A 时,将  $10k\Omega$  电阻接地会产生 0V 至 2V 的电压。IMON 可兼容 0V 至 3V 的电压。在应用电路中,需在  $R_{MON}$  处并联一个 10nF 以上的电容。



## 应用信息

### 电流限设置(R<sub>SET</sub>)

由于电流采样存在公差,MP5022C 限流值应高于正常的最大负载电流值。限流值可使用公式(5)设置:

$$I_{LIMIT} = \frac{1.3(V)}{R_{SET}} \times 10^{5} (A)$$
 (5)

当设置的电流限低于 7A 时,需在 ISET 电阻处 并联一个 R-C 电路(见图 7)。通常,选择  $R=20k\Omega$ ,C=560pF。

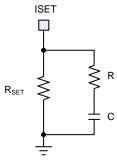


图 7: 用于 ISET 的 R-C 滤波电路

图 8 显示了当限流值大于 7A 时,RSET 电阻值与限流值的关系图。表 2 提供了基于评估板的测试结果。

表 2: 限流值对比限流电阻

限流电阻(kΩ)	6.8	16.2	32.4
限流值(A)	19	8	4.06

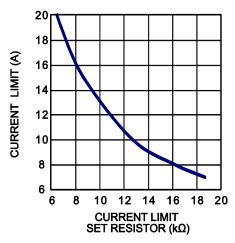


图 8: 限流值 vs. R<sub>SET</sub> 值(限流值≥7A)

图 9 显示了 RSET 电阻对比 7A 电流及以下电流限的图形视图。

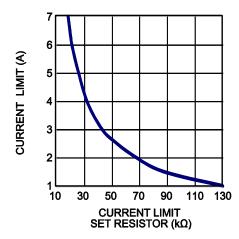


图 9: 限流值 vs. R<sub>SET</sub> 值(限流值<7A)

#### 电流监控设置

MP5022C 可以监控流过功率 MOSFET 的电流。在 IMON 与地之间连接一个电阻(R<sub>MON</sub>),用来设置输出增益。如公式(6)所示:

$$I_{MON} = \frac{I_{POWER\_FET}}{10^5} (A)$$
 (6)

其中 I<sub>POWER\_FET</sub> 是功率 MOSFET 的电流。在 IMON 与 GND 之间放置一个 10kΩ 电阻,增益 为 100mV/A。在 IMON 与 GND 之间接一个大于 10nF 的电容来稳定 IMON 输出电压。



#### 布局指南

高效的 PCB 布局对于 IC 工作的稳定性至关重要。为获得最佳效果,请参考图 10 并遵循以下指南:

- 1. 在电路板输入端和输出端之间放置的大电流 路径,电流返回路径与最小回路并联,以减 小环路电感。
- 2. 在 VIN 放置一个瞬态电压抑制二极管 (TVS)。
- 3. 将TVS尽可能靠近VIN放置。

TVS用于吸收系统由于输入线路电压尖峰,以及在MP5022C的负载电流急剧下降时,在VIN处产生的电压尖峰。

4. 将 MP5022C 的 GND 连接到一个小的接地岛,用来作为芯片所有信号地的参考。

该信号GND岛可以通过单点接地方法连接到系统的主功率GND。

- 5. 确保VIN上的输入去耦电容到VIN和到GND的 走线最短。
- 6. 将肖特基二极管靠近VOUT和GND,以在功率FET关闭时吸收负电压尖峰。
- 7. 将输出电容放置在尽可能靠近MP5022C的位置,从而尽量减少PCB寄生电感的影响。
- 8. 保持IN和GND焊盘与铺铜连接。
- 9. 在导热垫上添加过孔,以获得更好的散热性能。
- 10. 确保连接所有VIN和VOUT引脚,以实现每个引脚的电流分布相等。

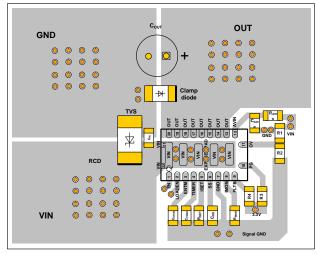


图 10: 推荐布局

#### 设计实例

详细的应用原理图如图 11、图 12 和图 13 所示。图 11 显示了电流限≥7A 的应用电路图。图 12 显示了电流限<7A 的应用电路图。图 13 显示了未使用 LOADEN 的应用电路图。典型性能特性和波形图请见对应章节。更多详细设备应用,请参考相关评估板规格书。



### 典型应用电路

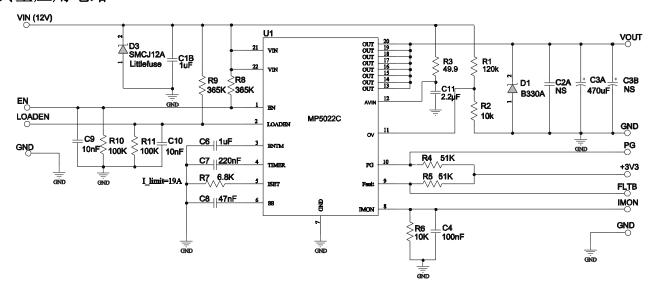


图 11: 限流值≥7A 的应用

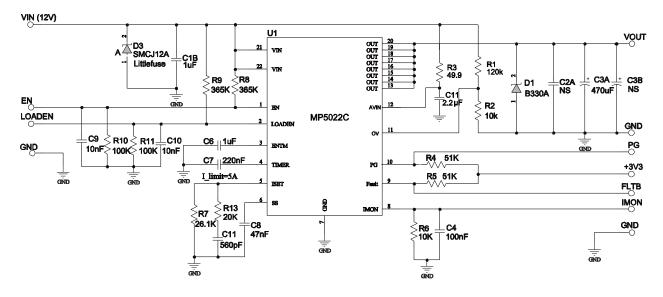


图 12: 限流值<7A 的应用



### 典型应用电路(续)

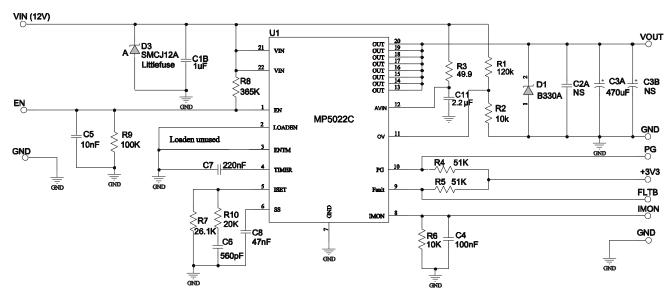
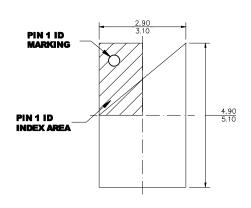


图 13: 未使用 LOADEN



## 封装信息

#### QFN-22 (3mmx5mm)



0.45 0.50 PIN1 ID 0.20 0.30 PIN1 ID 0.50 0.125 X45°TYP

20 2.125 1.875

0.20 0.20 0.00

BSC 0.20 0.00

0.50 0.20 0.00

0.50 0.20 0.00

0.50 0.20 0.00

0.50 0.20 0.00

0.50 0.20 0.00

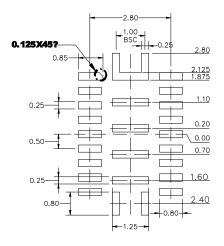
0.50 0.20 0.00

**TOP VIEW** 

**BOTTOM VIEW** 



**SIDE VIEW** 



**RECOMMENDED LAND PATTERN** 

#### **NOTE:**

- 1) ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
- 2) EXPOSED PADDLE SIZE DOES NOT INCLUDE MOLD FLASH.
- 3) LEAD COPLANARITY SHALL BE 0.10 MILLIMETERS MAX.
- 4) JEDEC REFERENCE IS MO-220.
- 5) DRAWING IS NOT TO SCALE.

注:本文中信息如有变更,不另通知。当前所用规格,请联系 MPS。用户应确保其对 MPS 产品的具体应用不侵犯他人知识产权。MPS 不对此类应用承担任何法律责任。